

特性

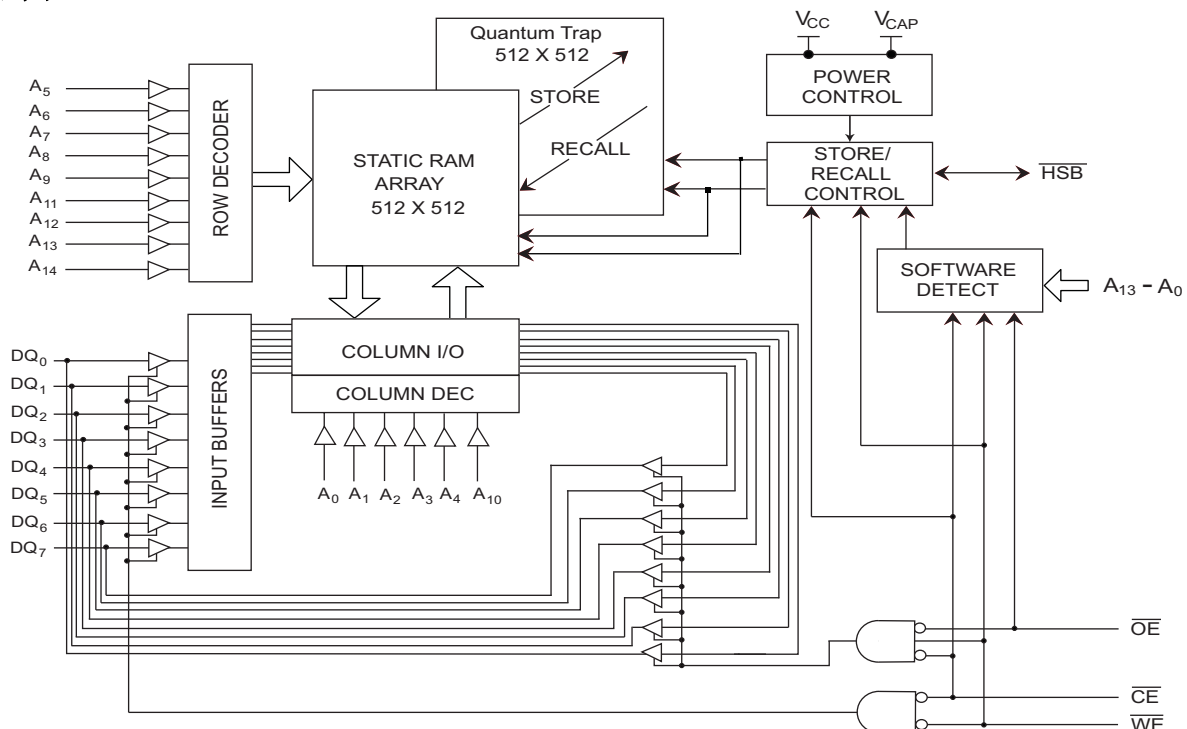
- 访问时间为 25 ns 和 45 ns
- 内部采用了 32 K x 8 的组织方式 (CY14B256LA)
- 只需一个小电容, 即可在断电时实现自动存储
- 可通过软件、器件引脚或断电时自动存储来触发存储至 QuantumTrap 非易失性元件
- 可通过软件或加电触发回读至 SRAM
- 无限次读、写和回读周期
- 一百万次的 QuantumTrap 存储周期
- 20 年的数据保留时间
- 在 3 V (+20% 到 -10%) 的单电源供电情况下的操作
- 工业级温度
- 44 引脚薄小外形封装 (TSOP) II 型、48 引脚紧缩小外形封装 (SSOP) 和 32 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装
- 无铅, 并满足有害物质限制 (RoHS) 规定

功能说明

赛普拉斯 CY14B256LA 是一种快速静态 RAM, 且每个存储器单元中都包含非易失性元件。该存储器采用“32 K 字节, 每字节 8 位”的组织方式。嵌入式非易失性元件通过采用 QuantumTrap 技术, 打造出了世界上最可靠的非易失性存储器。SRAM 能够实现无限次读写周期, 而独立的非易失性数据则存储在高度可靠的 QuantumTrap 单元中。断电时, 数据会从 SRAM 自动转移到非易失性元件内 (“存储”操作)。加电时, 数据会从非易失性存储器存储到 SRAM (“回读”操作)。也可以在软件控制下执行“存储”和“回读”操作。

要获取相关文档的完整列表, 请单击[此处](#)。

逻辑框图



目录

引脚分布	3	交流切换特性	11
引脚定义	4	切换波形	11
器件运行	5	自动存储 / 加电回读	13
SRAM 读取	5	切换波形	13
SRAM 写入	5	软件控制的存储 / 回读周期	14
自动存储操作	5	切换波形	14
硬件存储操作	5	硬件存储周期	15
硬件回读 (加电)	6	切换波形	15
软件存储	6	SRAM 操作的真值表	16
软件回读	6	订购信息	16
阻止自动存储	7	订购代码定义	16
数据保护	7	封装图	17
最大额定值	8	缩略语	20
工作范围	8	文档规范	20
直流电气特性	8	测量单位	20
数据保留时间与耐久性	9	文档修订记录页	21
电容	9	销售、解决方案和法律信息	22
热阻	9	全球销售和设计支持	22
交流测试负载	10	产品	22
交流测试条件	10	PSoC 解决方案	22

引脚分布

图 1. 44 引脚 TSOP II /48 引脚 SSOP 的引脚分配

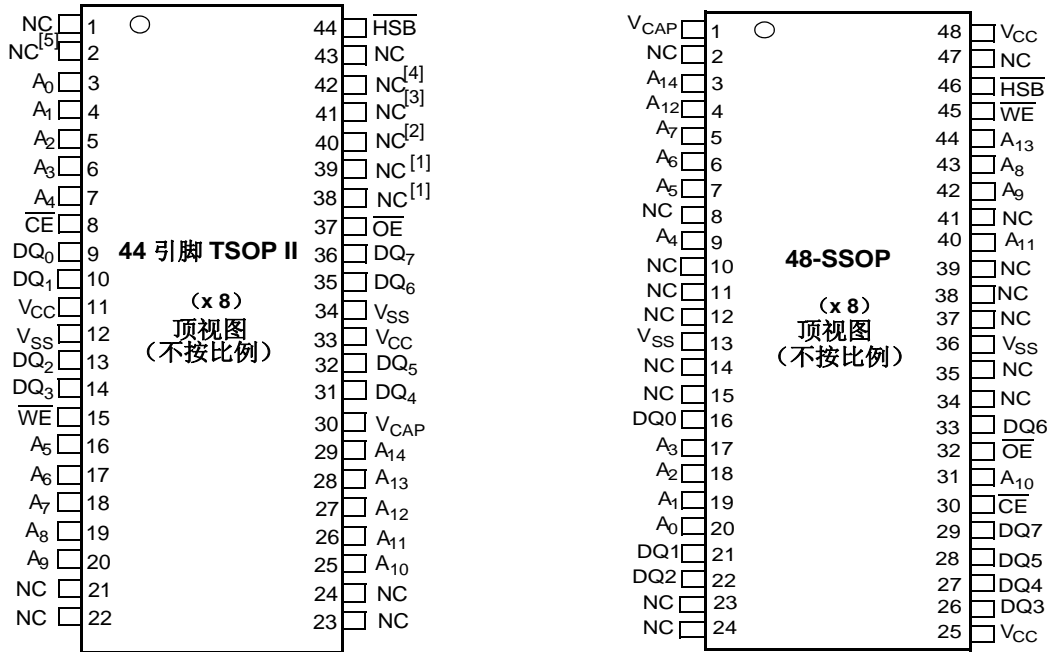
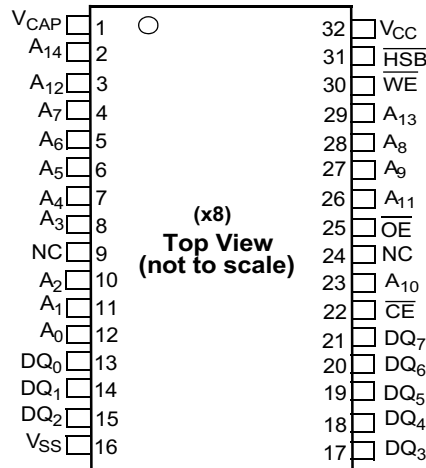


图 2. 32 引脚 SOIC 的引脚分布



注释:

- 1 Mbit 的地址扩展。NC 引脚未连接到芯片。
- 2 Mbit 的地址扩展。NC 引脚未连接到芯片。
- 4 Mbit 的地址扩展。NC 引脚未连接到芯片。
- 8 Mbit 的地址扩展。NC 引脚未连接到芯片。
- 16 Mbit 的地址扩展。NC 引脚未连接到芯片。

引脚定义

引脚名称	I/O 类型	说明
A ₀ -A ₁₄	输入	地址输入。用于选择 nvSRAM 的 32,768 字节中的某个字节。
DQ ₀ -DQ ₇	输入 / 输出	双向数据 I/O 线。根据操作将该引脚作为输入或输出线路使用。
\overline{WE}	输入	低电平有效的写使能输入。当使能芯片，并 WE 为低电平时，I/O 引脚上的数据被写入到指定的地址位置内。
\overline{CE}	输入	低电平有效的芯片使能输入。如果该引脚为低电平，将选择芯片。如果该引脚为高电平，则取消选择芯片。
\overline{OE}	输入	低电平有效的输出使能。低电平有效输入 \overline{OE} 在读周期内使能数据输出缓冲器。在取消激活高电平的 \overline{OE} 时，I/O 引脚会进入三态。
V _{SS}	接地	器件的接地引脚。必须连接至系统地面。
V _{CC}	电源	器件的电源输入。3.0 V + 20%，-10%
\overline{HSB}	输入 / 输出	硬件存储繁忙 (\overline{HSB})。当该输出为低电平时，它表示硬件存储正在执行过程中。当在芯片外部将其置于低电平时，它表示一个非易失性存储操作。每当实现硬件和软件存储后，HSB 在较短时间 (t_{HHHD}) 内通过标准输出高电流变为高电平，然后通过内部弱上拉电阻一直保持高电平状态（外部上拉电阻连接可选）。
V _{CAP}	电源	自动存储电容。在断电期间给 nvSRAM 供电是为了在该过程中将数据从 SRAM 存储到非易失性元件内。
NC	无连接	无连接。该引脚未连接到芯片。

器件运行

CY14B256LAnvSRAM由两个相同物理单元中的成对功能组件组成。它们分别是一个 SRAM 存储器单元和一个非易失性 QuantumTrap 单元。SRAM 存储器单元可作为标准快速静态 RAM 工作。SRAM 中的数据被传输到非易失性单元（存储操作），或从非易失性单元传输到 SRAM（回读操作）。使用该独特的架构，所有单元都可以并行执行存储和回读操作。在执行存储和回读操作期间，SRAM 读写操作被禁止。与典型的 SRAM 相同，CY14B256LA 支持无限次的读写操作。此外，它还提供无限次从非易失性单元的回读操作以及最多 100 万次存储操作。请参考第 16 页上的 SRAM 操作的真值表，了解读写模式完整的说明。

SRAM 读取

当 \overline{CE} 和 \overline{OE} 均为低电平，并且 \overline{WE} 和 \overline{HSB} 均为高电平时，CY14B256LA 将执行读周期。 A_{0-14} 引脚上所指定的地址决定了将对 32,768 个数据字节中进行访问的字节。当通过某个地址转换触发读取操作时，输出将经过 t_{AA} （读取周期 1）时长的延迟后有效。如果读取由 \overline{CE} 或 \overline{OE} 触发，则输出在 t_{ACE} 或 t_{DOE} 中较迟者的时间内有效（读取周期 2）。数据输出在 t_{AA} 访问时间内反复响应地址变化，而不需要切换任何控制输入引脚。这一直有效，直到另一个地址变化或直到 \overline{CE} 或 \overline{OE} 变为高电平，或 \overline{WE} 或 \overline{HSB} 变为低电平为止。

SRAM 写入

当 \overline{CE} 和 \overline{WE} 均为低电平且 \overline{HSB} 为高电平时，将执行写循环。地址输入稳定下来后才能进入写周期，并且该输入必须保持稳定状态，直到 \overline{CE} 或 \overline{WE} 在周期结束时变为高电平为止。如果在 \overline{WE} 控制的写操作结束前或在 \overline{CE} 控制的写操作结束前，数据在 t_{SD} 时间内有效，那么通用 I/O 引脚 DQ_{0-7} 上的数据将被写入到存储器中。在整个写周期期间保持 \overline{OE} 为高电平可以避免通用 I/O 线路上出现数据总线冲突。如果 \overline{OE} 为低电平，那么在 \overline{WE} 变为低电平之后，内部电路将在 t_{HZWE} 时间内关闭输出缓冲器。

自动存储操作

CY14B256LA 通过下面三个方法中的一个，可以将数据存储到 nvSRAM 内：由 \overline{HSB} 激活的硬件存储操作；由地址序列激活的软件存储操作；器件断电时的自动存储操作。自动存储操作是 QuantumTrap 技术独有的特性，在 CY14B256LA 上默认使能了该特性。

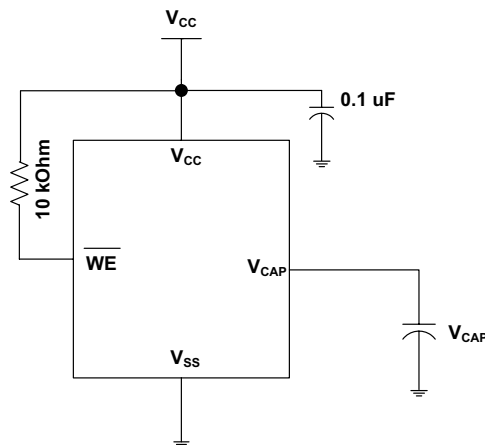
在正常工作时，器件从 V_{CC} 接收电流，进而给与 V_{CAP} 引脚连接的电容充电。芯片使用该存储的电荷执行单个存储操作。如果 V_{CC} 引脚的电压降到 V_{SWITCH} 以下，器件将自动断开 V_{CAP} 引脚与 V_{CC} 的连接。通过 V_{CAP} 电容提供的电源触发存储操作。

注意：如果电容未与 V_{CAP} 引脚连接，那么必须使用第 7 页上的阻止自动存储中指定的软序列来禁用自动存储操作。如果在没有 V_{CAP} 引脚上的电容时使能自动存储，则器件将在未足够电荷的情况下尝试自动存储操作以完成存储。这会破坏 nvSRAM 中存储的数据。

图 3 显示的是自动存储操作要求的存储电容 (V_{CAP}) 正确连接。请参考第 8 页上的直流电气特性，了解 V_{CAP} 的大小。 V_{CAP} 引脚上的电压通过芯片上的电压调节器输入到 V_{CC} 。将一个上拉电阻放置在 \overline{WE} 上，以便在加电过程中使其保持为非活动状态。只有 \overline{WE} 信号在加电期间处于三态时，该上拉电阻才有效。很多 MPU 在加电时会使它们的控制引脚进入高阻态。使用上拉电阻时必须验证这种情况。当 nvSRAM 退出加电回读时，MPU 必须处于活动状态或者 \overline{WE} 保持无效状态，直到 MPU 退出复位状态为止。

为了降低不必要的非易失性存储，将忽略自动存储和硬件存储操作，除非在最新的存储或回读周期后至少发生了一次写操作。无论是否发生写操作，都会执行软件触发的存储循环。系统会监控 \overline{HSB} 信号，以检测是否正在执行自动存储周期。

图 3. 自动存储模式



硬件存储操作

CY14B256LA 提供了 \overline{HSB} 引脚，用于控制和确定存储操作。使用 \overline{HSB} 引脚来请求硬件存储周期。当 \overline{HSB} 引脚被设置为低电平时，CY14B256LA 将经过 t_{DELAY} 时间后会有条件地启动存储操作。仅在最后一个存储或回读周期后发生了对 SRAM 的写操作时才开始实际的存储周期。 \overline{HSB} 引脚还作为开漏驱动器（内部 100 kΩ 弱上拉电阻）使用，它在进行存储操作（通过任何手段触发）时会内部变为低电平，以指示其繁忙状态。

注意：每次进行硬件和软件存储操作后， \overline{HSB} 都会在一段较短的时间内 (t_{HHHD}) 从标准输出高电流变为高电平，然后通过内部 100 kΩ 的上拉电阻保持这种高电平状态。

在 \overline{HSB} 通过某些手段变为低电平时所进行的 SRAM 写操作要在启动存储操作前给定的时间 (t_{DELAY}) 内完成。但是，在 \overline{HSB} 变为低电平后请求的任何 SRAM 写周期都被禁止，直到 \overline{HSB} 变回高电平。如果未设置写锁存，那么 \overline{HSB} 不会被 CY14B256LA 置为低电平。但是所有 SRAM 读和写周期都被禁止，直到 MPU 或其他外部源使 \overline{HSB} 变回高电平为止。

在任何存储操作期间，无论它如何启动，CY14B256LA 都会继续将 HSB 引脚置为低电平，仅在存储完成时才会释放。完成存储操作，并且 HSB 引脚返回到高电平后，nvSRAM 存储器访问将在 t_{LZHSB} 时间内被禁止。如果不使用 HSB，请保持它的未连接状态。

硬件回读（加电）

上电时或任何低功率状态之后 ($V_{CC} < V_{SWITCH}$)，内部回读请求将被锁存。如果 V_{CC} 再次超过了 V_{SWITCH} 的检测电压，将自动启动回读周期并需要经过 $t_{HRECALL}$ 的时间来完成。在此期间内，HSB 驱动器会将 HSB 置为低电平。

软件存储

通过软件地址序列将数据从 SRAM 传输到非易失性存储器内。按顺序准确从六个特定地址执行连续的 \overline{CE} 或 \overline{OE} 控制的读周期后，可以启动 CY14B256LA 软件存储周期。在存储周期期间，首先擦除上一个非易失性数据，接下来执行非易失性元件程序。启动存储周期后，将禁用后续的输入和输出，直到该周期完成为止。

由于特定地址的读取序列用于存储启动，所以在该序列中要避免其他读或写访问的干预，否则该序列将被中止，并且不会发生任何存储或回读操作。

想要启动软件存储周期，必须执行下列读取序列：

1. 读取地址 0x0E38，有效读取
2. 读取地址 0x31C7，有效读取
3. 读取地址 0x03E0，有效读取
4. 读取地址 0x3C1F，有效读取
5. 读取地址 0x303F，有效读取
6. 读取地址 0x0FC0，启动存储周期

当 \overline{WE} 在六个读取序列中始终保持为高电平状态时，可以通过 \overline{CE} 控制的读取或 \overline{OE} 控制的读取给软件序列提供时钟脉冲。在序列中输入第六个地址之后，存储周期将立即开始，且芯片被禁用。HSB 被置为低电平。达到 t_{STORE} 周期时间后，SRAM 再次被激活以进行读和写操作。

软件回读

通过软件地址序列将非易失性存储器内的数据传输到 SRAM 中。软件回读周期以与软件存储启动类似的方式通过读操作序列启动。若要启动回读周期，必须执行下列 \overline{CE} 或 \overline{OE} 所控制的读操作序列：

1. 读取地址 0x0E38，有效读取
2. 读取地址 0x31C7，有效读取
3. 读取地址 0x03E0，有效读取
4. 读取地址 0x3C1F，有效读取
5. 读取地址 0x303F，有效读取
6. 读取地址 0x0C63，启动回读周期

在内部，回读程序包括两个步骤。首先，清除 SRAM 数据。然后，将非易失性信息传输到 SRAM 单元中。经过 t_{RECALL} 周期时间后，SRAM 再次处于就绪状态，以进行读和写操作。回读操作不会更改非易失性元件中的数据。

表 1. 模式选择

\overline{CE}	\overline{WE}	\overline{OE}	$A_{14}-A_0$ ^[6]	模式	I/O	电源
H	X	X	X	未选中	输出高阻态	待机
L	H	L	X	读取 SRAM	输出数据	活动
L	L	X	X	写入 SRAM	输入数据	活动
L	H	L	0x0E38 0x31C7 0x03E0 0x3C1F 0x303F 0x0B45	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 自动存储禁用	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据	有效 ^[7]

注释：

6. CY14B256LA 上有 15 个地址行，其中只有较低的 14 个地址行被用于控制软件模式。
7. 六个连续的地址必须按顺序列出。 \overline{WE} 在六个周期期间必须为高电平才能使非易失性循环。

表 1. 模式选择 (续)

\overline{CE}	\overline{WE}	\overline{OE}	A ₁₄ -A ₀ ^[6]	模式	I/O	电源
L	H	L	0x0E38 0x31C7 0x03E0 0x3C1F 0x303F 0x0B46	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 自动存储使能	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据	活动 ^[8]
L	H	L	0x0E38 0x31C7 0x03E0 0x3C1F 0x303F 0x0FC0	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 非易失性存储	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出高阻态	活动 I _{CC2} ^[8]
L	H	L	0x0E38 0x31C7 0x03E0 0x3C1F 0x303F 0x0C63	读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 读取 SRAM 非易失性回读	输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出数据 输出高阻态	活动 ^[8]

阻止自动存储

通过启动自动存储禁用的序列，可以禁用自动存储功能。与软件存储启动类似的方式执行读操作序列。如要启动自动存储禁用序列，必须执行下面 \overline{CE} 或 \overline{OE} 控制的读操作序列：

1. 读取地址 0x0E38，有效读取
2. 读取地址 0x31C7，有效读取
3. 读取地址 0x03E0，有效读取
4. 读取地址 0x3C1F，有效读取
5. 读取地址 0x303F，有效读取
6. 读取地址 0x0B45，自动存储被禁用

通过启动自动存储使能序列，可以重新使能自动存储功能。与软件回读启动类似的方式执行读操作序列。如果要启动自动存储使能序列，必须执行下列 \overline{CE} 或 \overline{OE} 控制的读操作序列：

1. 读取地址 0x0E38，有效读取
2. 读取地址 0x31C7，有效读取
3. 读取地址 0x03E0，有效读取
4. 读取地址 0x3C1F，有效读取
5. 读取地址 0x303F，有效读取
6. 读取地址 0x0B46，自动存储使能

如果禁用或重新使能自动存储功能，则必须触发手动存储操作（软件或硬件）才能在后续的断电循环中保存自动存储。器件出厂时已使能自动存储功能，且已在所有单元中写入了 0x00。

数据保护

CY14B256LA 通过禁止外部启动的存储和写操作，可以避免在低电压状态下破坏数据。当 V_{CC} 低于 V_{SWITCH} 时，将检测到低电压状态。如果 CY14B256LA 在加电时处于写模式（ \overline{CE} 和 \overline{WE} 均为低电平），则在回读或存储后将禁止写操作，直到经过 t_{LZHSB} （HSB 到输出有效的时间）时间后使能 SRAM 为止。这样可以防止在加电或断电时发生意外写操作。

注释：

8. 六个连续的地址必须按顺序列出。 \overline{WE} 在六个周期期间必须为高电平才能使能非易失性循环。

最大额定值

超过最大额定值可能会影响器件的使用寿命。这些用户指导未经过测试。

存储温度..... -65 °C 到 +150 °C

最长的累积存储时间:

在 150°C 环境温度下,

累积存储时间为..... 1000 个小时

在 85°C 环境温度下, 累积存储时间为..... 20 年

最高结温..... 150°C

V_{CC} (相对于 V_{SS}) 的供电电压范围为..... -0.5 V 到 4.1 V

应用于高阻态的输出电压..... -0.5 V 到 V_{CC} + 0.5 V

输入电压..... -0.5 V 到 V_{CC} + 0.5 V

处于接地电位的所有引脚上的

瞬变电压 (< 20 ns) -2.0 V 到 V_{CC} + 2.0 V

封装功率散耗能力

(T_A = 25 °C) 1.0 W

表面贴装铅焊温度 (3 秒) +260 °C

直流输出电流

(每次只输出 1 路电流, 持续时间为 1 秒) 15 mA

静电放电电压

(根据 MIL-STD-883, 方法 3015) > 2001 V

闩锁电流..... > 200 mA

工作范围

范围	环境温度	V _{CC}
工业级	-40°C 至 +85°C	2.7 V 至 3.6 V

直流电气特性

在工作范围内

参数	说明	测试条件	最小值	典型值 ^[9]	最大值	单位
V _{CC}	电源		2.7	3.0	3.6	V
I _{CC1}	平均电流 V _{CC}	t _{RC} = 25 ns t _{RC} = 45 ns 无输出负载下取得的值 (I _{OUT} = 0 mA)	-	-	70 52	mA mA
I _{CC2}	存储过程中的 V _{CC} 平均电流	所有输入无需关注, V _{CC} = t _{STORE} 期间的最大平均电流	-	-	10	mA
I _{CC3}	在 t _{RC} = 200 ns、V _{CC(Typ)} 、25 °C 条件下的 V _{CC} 平均电流	所有输入在 CMOS 电平循环。 无输出负载下取得的值 (I _{OUT} = 0 mA)。	-	35	-	mA
I _{CC4}	自动存储周期期间的 V _{CAP} 平均电流	所有输入无需关注。t _{STORE} 期间的平均电流	-	-	5	mA
I _{SB}	V _{CC} 待机电流	$\overline{CE} \geq (V_{CCQ} - 0.2 V)$ 。 $V_{IN} \leq 0.2 V$ 或 $\geq (V_{CC} - 0.2 V)$ 。 非易失性循环完成后的待机电流强度。 输入处于静态状态。f = 0 MHz。	-	-	5	mA
I _{IX} ^[10]	输入漏电流 (HSB 除外)	V _{CC} = 最大值, V _{SS} ≤ V _{IN} ≤ V _{CC}	-1	-	+1	μA
	输入漏电流 (适用于 HSB)	V _{CC} = 最大值, V _{SS} ≤ V _{IN} ≤ V _{CC}	-100	-	+1	μA
I _{OZ}	断开状态输出漏电流	V _{CC} = 最大值, V _{SS} ≤ V _{OUT} ≤ V _{CC} , CE 或 OE ≥ V _{IH} 或 WE ≤ V _{IL}	-1	-	+1	μA
V _{IH}	输入高电平电压		2.0	-	V _{CC} + 0.5	V
V _{IL}	输入低电平电压		V _{SS} - 0.5	-	0.8	V
V _{OH}	输出高电平电压	I _{OUT} = -2 mA	2.4	-		V
V _{OL}	输出低电平电压	I _{OUT} = 4 mA	-	-	0.4	V

注释:

9. 典型值的温度为 25°C、V_{CC} = V_{CC(Typ)}。并未经过 100% 测试。

10. 如果高电平有效和低电平有效的驱动程序均被禁用, 那么对于 HSB 引脚, 当 V_{OH} 等于 2.4 V 时, I_{OUT} = -2 μA。使能这些驱动程序后, 标准 V_{OH} 和 V_{OL} 均有效。该参数被特性化, 且非 100% 均经过测试。

直流电气特性（续）

在工作范围内

参数	说明	测试条件	最小值	典型值 ^[9]	最大值	单位
$V_{CAP}^{[11]}$	存储电容	介于 V_{CAP} 引脚和 V_{SS} 之间	61	68	180	μF
$V_{VCAP}^{[12, 13]}$	器件在 V_{CAP} 引脚上的最大驱动电压	$V_{CC} = \text{最大值}$	-	-	V_{CC}	V

数据保留时间与耐久性

在工作范围内

参数	说明	最小值	单位
$DATA_R$	数据保留时间	20	年
NV_C	执行非易失性存储操作的次数	1,000	K

电容

参数 ^[13]	说明	测试条件	最大值	单位
C_{IN}	输入电容 (\overline{HSB} 除外)	$T_A = 25^\circ C$ 、 $f = 1 \text{ MHz}$ 、 $V_{CC} = V_{CC(Typ)}$	7	pF
	输入电容 (适用于 \overline{HSB})		8	pF
C_{OUT}	输出电容 (\overline{HSB} 除外)		7	pF
	输出电容 (适用于 \overline{HSB})		8	pF

热阻

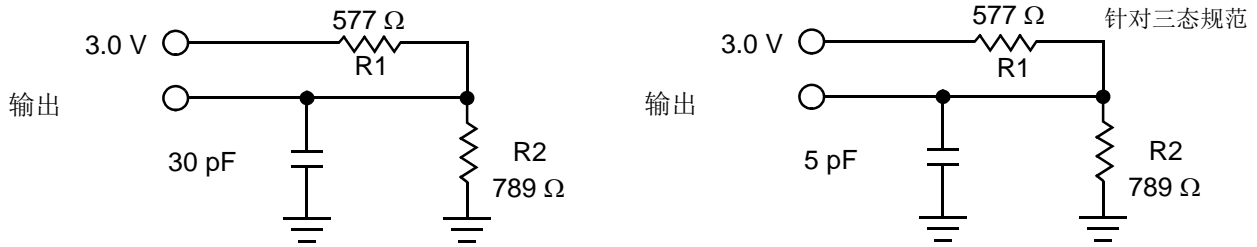
参数 ^[13]	说明	测试条件	48 引脚 SSOP	44 引脚 TSOP II	32 引脚 SOIC	单位
Θ_{JA}	热电阻 (结温到室温)	根据 EIA/JESD51 的要求, 测试条件遵循测试热电阻的标准测试方法和流程。	37.47	41.74	41.55	$^\circ C/W$
Θ_{JC}	热电阻 (结温至壳温)		24.71	11.9	24.43	$^\circ C/W$

注释:

- 最小的 V_{CAP} 值要保证能够提供顺利完成自动存储操作所需要的电荷。在加电回读周期内, V_{CAP} 的最大值确保使用了最小的电压给 V_{CAP} 上的电容充电。这样, 在紧急断电期间, 可以顺利地自动存储操作。因此, 建议始终使用在指定最小和最大极限值内的电容。请参考应用笔记 AN43593, 了解有关 V_{CAP} 选项的详细信息。
- 当选择 V_{CAP} 电容时, 可提供 V_{CAP} 引脚上的最大电压 (V_{VCAP}) 作为指导。在工作温度范围内, V_{CAP} 电容的额定电压应高于 V_{VCAP} 电压。
- 这些参数由设计保证, 但未进行过测试。

交流测试负载

图 4. 交流测试负载



交流测试条件

- 输入脉冲电平 0 V 到 3 V
- 输入上升和下降时间 (10% - 90%) ≤ 3 ns
- 输入和输出的时序参考电平 1.5 V

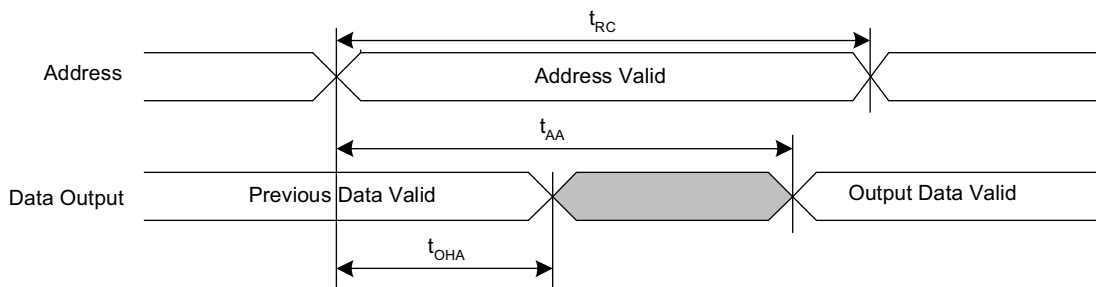
交流切换特性

在工作范围内

参数 ^[14]		说明	25 ns		45 ns		单位
赛普拉斯参数	备用参数		最小值	最大值	最小值	最大值	
SRAM 读周期							
t_{ACE}	t_{ACS}	芯片使能访问时间	-	25	-	45	ns
$t_{RC}^{[15]}$	t_{RC}	读周期的时间	25	-	45	-	ns
$t_{AA}^{[16]}$	t_{AA}	地址访问时间	-	25	-	45	ns
t_{DOE}	t_{OE}	输出使能到数据有效的时间	-	12	-	20	ns
$t_{OHA}^{[16]}$	t_{OH}	地址更改后的输出保持时间	3	-	3	-	ns
$t_{LZCE}^{[17, 18]}$	t_{LZ}	芯片使能到输出有效的时间	3	-	3	-	ns
$t_{HZCE}^{[17, 18]}$	t_{HZ}	芯片禁用到输出无效的时间	-	10	-	15	ns
$t_{LZOE}^{[17, 18]}$	t_{OLZ}	从输出使能到输出有效的时间	0	-	0	-	ns
$t_{HZOE}^{[17, 18]}$	t_{OHZ}	从输出禁用到输出无效的时间	-	10	-	15	ns
$t_{PU}^{[17]}$	t_{PA}	芯片使能到电源有效的时间	0	-	0	-	ns
$t_{PD}^{[17]}$	t_{PS}	芯片禁用到电源待机的时间	-	25	-	45	ns
SRAM 写周期							
t_{WC}	t_{WC}	写周期时间	25	-	45	-	ns
t_{PWE}	t_{WP}	写入脉冲宽度	20	-	30	-	ns
t_{SCE}	t_{CW}	芯片使能到写周期结束的时间	20	-	30	-	ns
t_{SD}	t_{DW}	数据建立到写周期结束的时间	10	-	15	-	ns
t_{HD}	t_{DH}	写周期结束后的数据保持时间	0	-	0	-	ns
t_{AW}	t_{AW}	地址建立到写周期结束的时间	20	-	30	-	ns
t_{SA}	t_{AS}	从地址建立到写周期开始的时间	0	-	0	-	ns
t_{HA}	t_{WR}	写周期结束后的地址保持时间	0	-	0	-	ns
$t_{HZWE}^{[17, 18, 19]}$	t_{WZ}	从写周期使能到输出禁用的时间	-	-	-	15	ns
$t_{LZWE}^{[17, 18]}$	t_{OW}	写周期结束后的输出有效时间	3	-	3	-	ns

切换波形

图 5. 第一个 SRAM 读周期（地址控制）^[15, 16, 20]



注释:

14. 测试条件采用等于或短于 3 ns 的信号跳变时间， $V_{CC}/2$ 的时序参考电平，0 至 $V_{CC}(typ)$ 的输入脉冲电平以及图中所示的指定 I_{OL}/I_{OH} 的输出负载和负载电容。
15. WE 必须在 SRAM 读周期内保持高电平状态。
16. 当 CE 和 OE 均为低电平时，会一直选中器件。
17. 这些参数由设计保证，但未进行过测试。
18. 稳定状态下所测量的输出电压为 ± 200 mV。
19. 如果 CE 变为低电平时 WE 处于低电平状态，输出会保持高阻抗状态。
20. 在读和写周期内，HSB 必须保持高电平状态。

切换波形 (续)

图 6. 第二个 SRAM 读周期 (\overline{CE} 和 \overline{OE} 控制) [21、22]

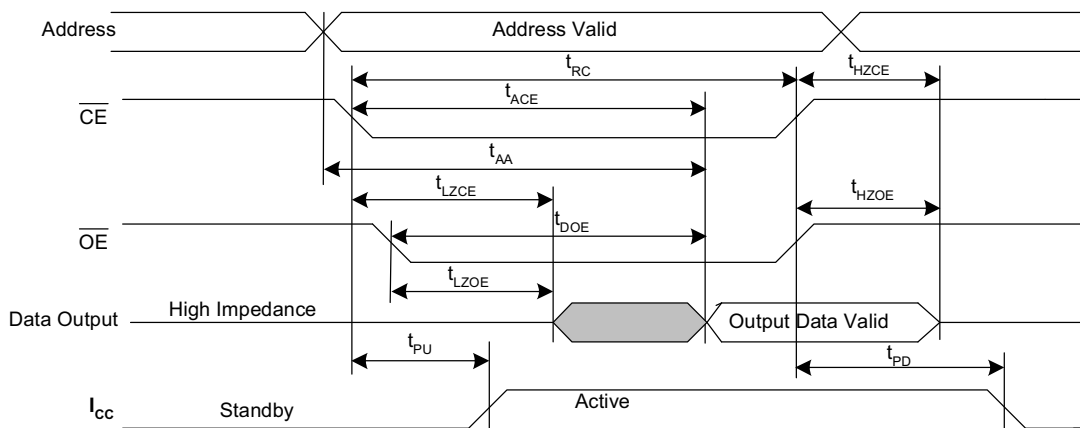


图 7. 第一个 SRAM 写周期 (\overline{WE} 控制) [22、23、24]

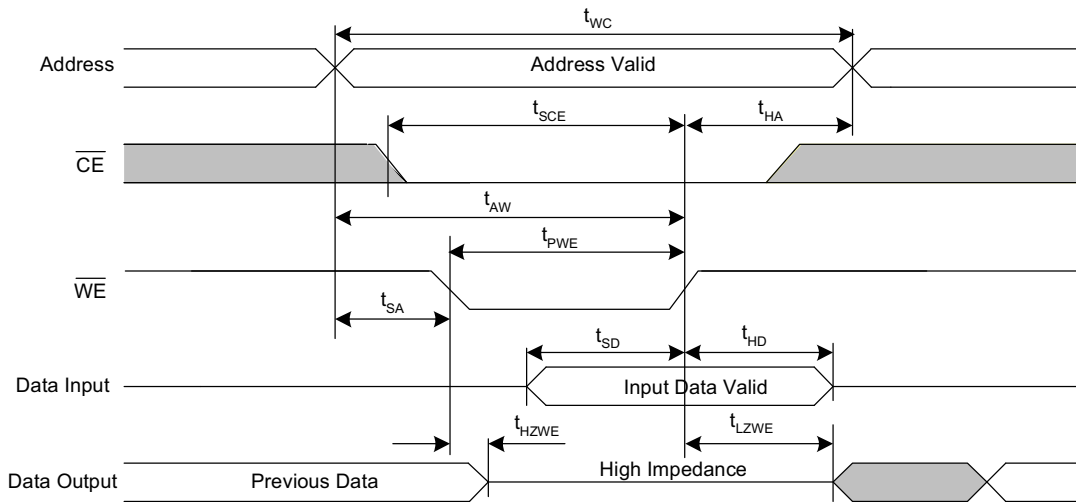
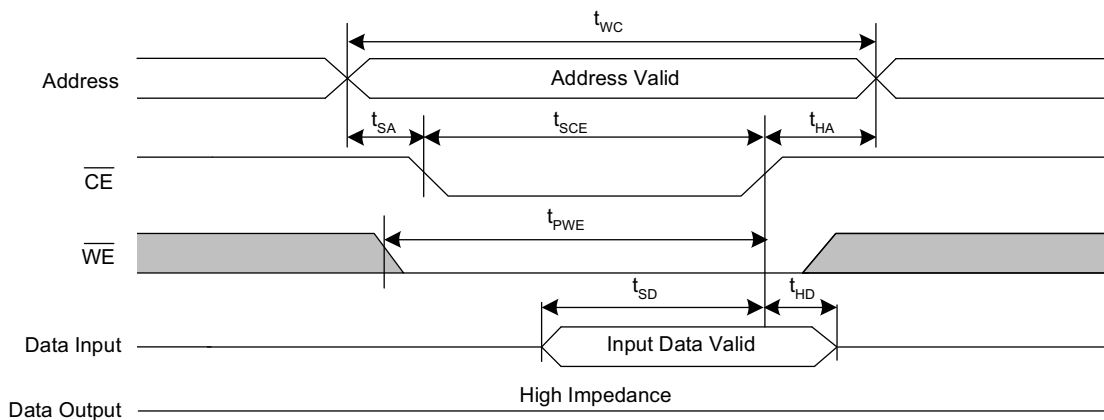


图 8. 第二个 SRAM 写周期 (\overline{CE} 控制) [22、23、24]



注释:

- 21. \overline{WE} 必须在 SRAM 读周期内保持高电平状态。
- 22. 在读和写周期内, \overline{HSB} 必须保持高电平状态。
- 23. 如果 \overline{CE} 变为低电平时 \overline{WE} 处于低电平状态, 输出会保持高阻抗状态。
- 24. 地址转换期间, \overline{CE} 或 \overline{WE} 必须 $\geq V_{IH}$ 。

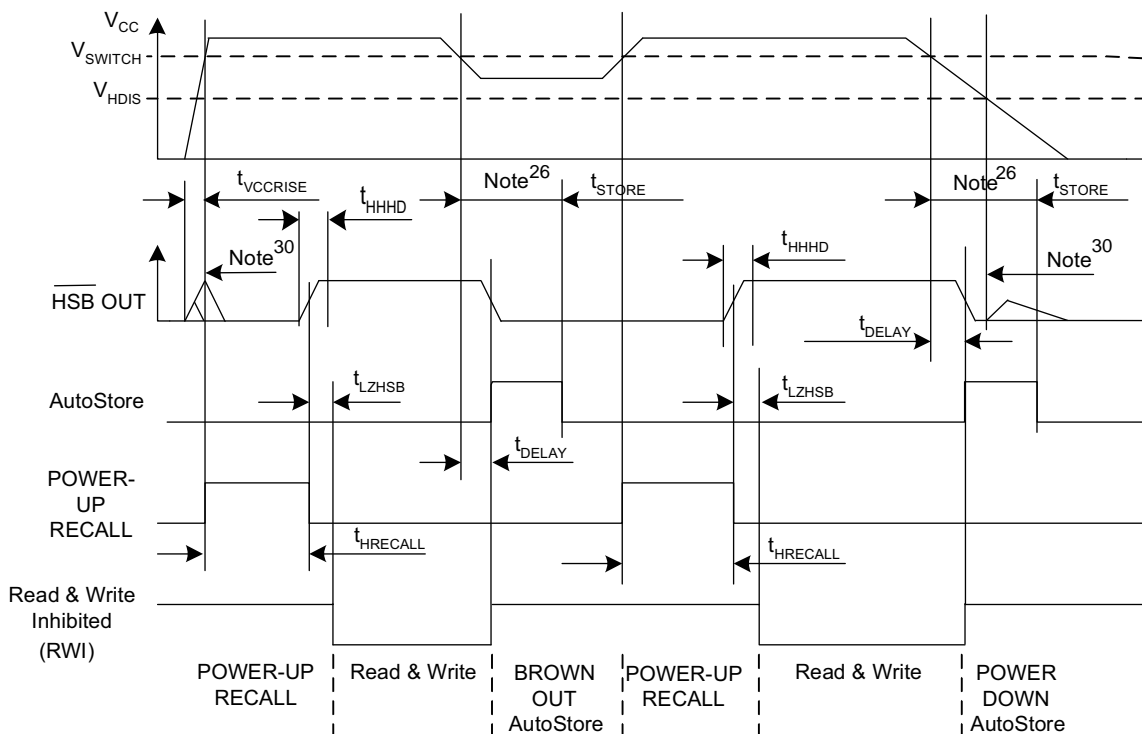
自动存储 / 加电回读

在工作范围内

参数	说明	CY14B256LA		单位
		最小值	最大值	
$t_{HRECALL}^{[25]}$	加电回读时间	—	20	ms
$t_{STORE}^{[26]}$	存储周期时间	—	8	ms
$t_{DELAY}^{[27]}$	完成 SRAM 写入周期所允许的时间	—	25	ns
V_{SWITCH}	低电压触发电平	—	2.65	V
$t_{VCCRRISE}^{[28]}$	V_{CC} 上升时间	150	—	μs
$V_{HDIS}^{[28]}$	\overline{HSB} 输出禁用电压	—	1.9	V
$t_{LZHSB}^{[28]}$	从 \overline{HSB} 到输出有效的的时间	—	5	μs
$t_{HHHD}^{[28]}$	\overline{HSB} 高电平有效时间	—	500	ns

切换波形

图 9. 自动存储或加电回读^[29]



注释:

- 25. 当 V_{CC} 大于 V_{SWITCH} 时, 将开始计算 $t_{HRECALL}$ 。
- 26. 如果完成最后一次非易失性循环后尚未对 SRAM 进行写操作, 则不会执行自动存储或硬件存储操作。
- 27. 在启动硬件存储和自动存储时, SRAM 写操作会在 t_{DELAY} 时间内持续使能。
- 28. 这些参数由设计保证, 但未进行过测试。
- 29. 在 V_{CC} 低于 V_{SWITCH} 的情况下, 在存储、回读的过程中会忽略读写周期。
- 30. 在通电和断电期间, 如果通过外部电阻上拉 HSB 引脚的电平, HSB 会发生短时脉冲。

软件控制的存储 / 回读周期

在工作范围内

参数 [31、32]	说明	25 ns		45 ns		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{RC}	存储 / 回读初始化周期的时间	25	-	45	-	ns
t_{SA}	地址建立时间	0	-	0	-	ns
t_{CW}	时钟脉冲宽度	20	-	30	-	ns
t_{HA}	地址保持时间	0	-	0	-	ns
t_{RECALL}	回读持续时间	-	200	-	200	μ s

切换波形

图 10. \overline{CE} 和 \overline{OE} 控制着软件存储 / 回读周期 [32]

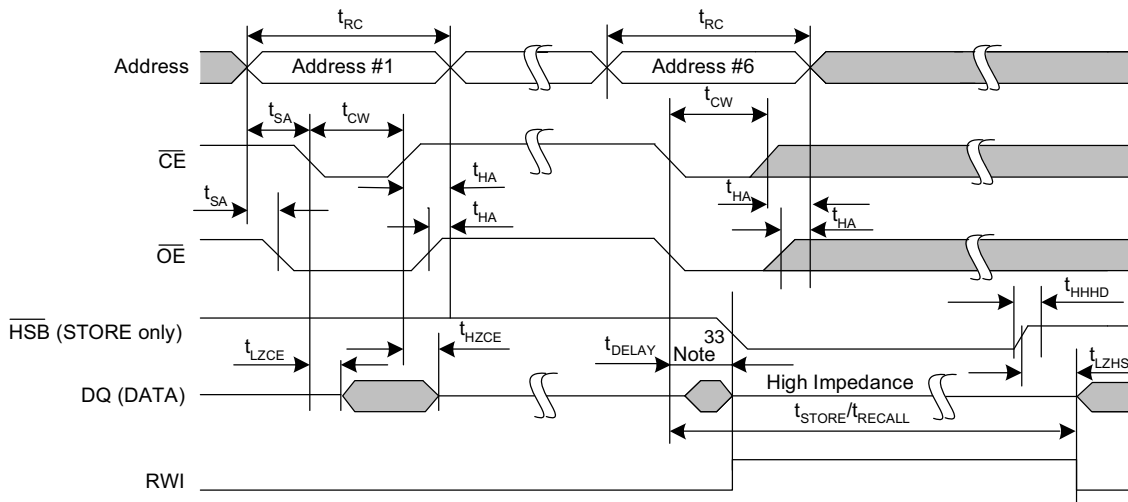
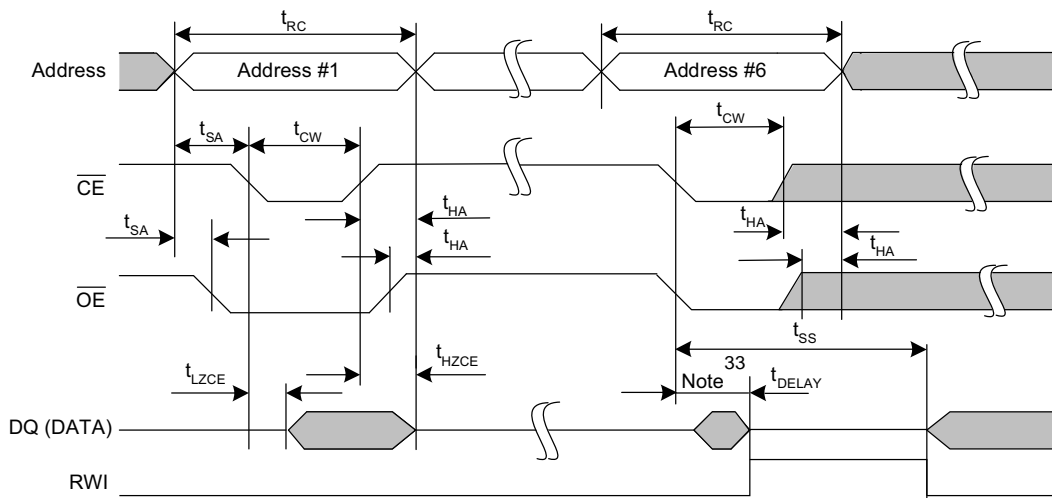


图 11. 自动存储使能 / 禁用周期 [32]



注释:

- 31. 由 \overline{CE} 控制的或 \overline{OE} 控制的读操作作为软件序列提供时钟脉冲。
- 32. 必须按第 6 页上的表 1 列出的顺序读取六个连续地址。在六个连续周期内， \overline{WE} 必须保持高电平状态。
- 33. 由于在 t_{DELAY} 时间内禁用输出，第六次读取的 DQ 输出数据可能无效。

硬件存储周期

在工作范围内

参数	说明	CY14B256LA		单位
		最小值	最大值	
t_{DHSB}	未设置写入锁存时从 HSB 到输出有效的时间	-	25	ns
t_{PHSB}	硬件存储脉冲宽度	15	-	ns
t_{SS} [34、35]	软序列处理时间	-	100	ms

切换波形

图 12. 硬件存储周期 [36]

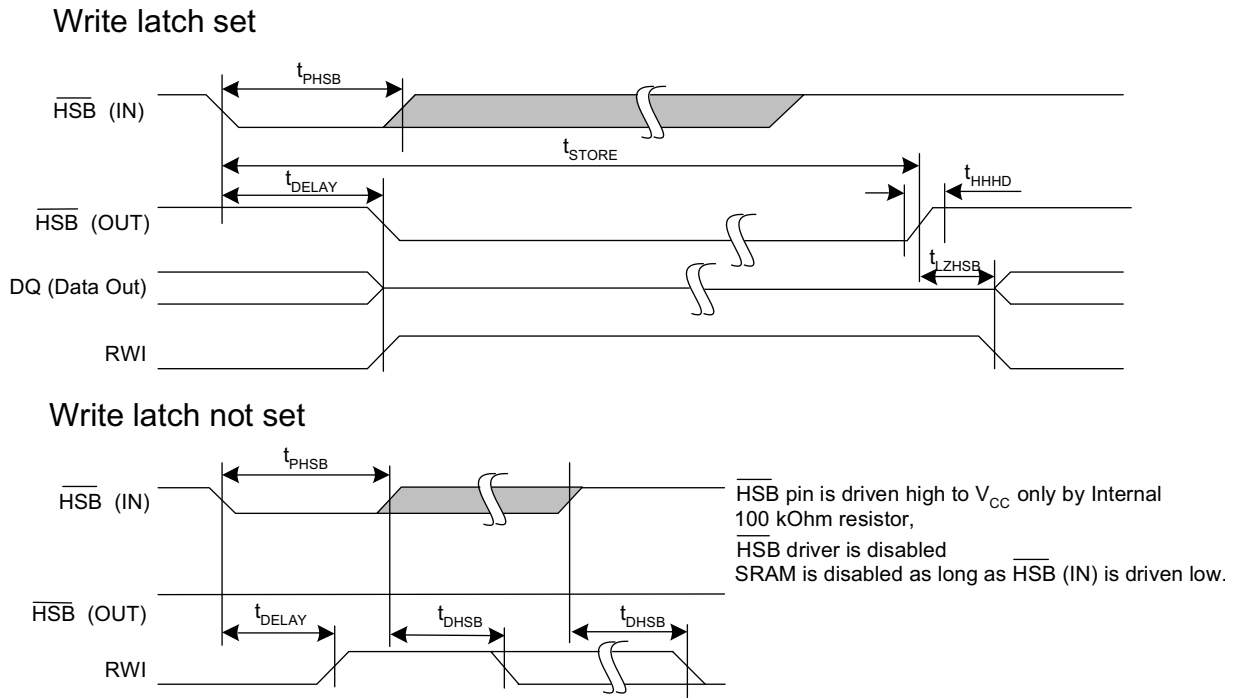
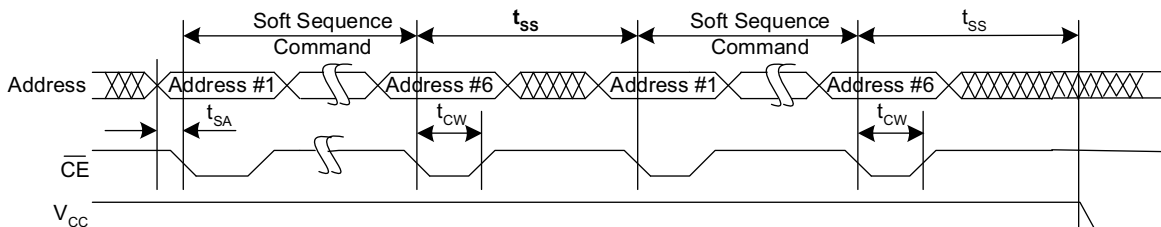


图 13. 软序列处理时间 [34、35]



注释:

- 34. 这是执行软序列指令所需要的时间。Vcc 电压必须保持高电平以保证有效地寄存指令。
- 35. 存储和回读等指令会锁定 I/O，直到完成操作为止，这样会使该时间延长更久。请参见特定的指令。
- 36. 如果完成最后一次非易失性循环后尚未对 SRAM 进行写操作，则不会执行自动存储或硬件存储操作。

SRAM 操作的真值表

在 SRAM 操作过程中， $\overline{\text{HSB}}$ 必须保持高电平状态。

表 2. 真值表

CE	WE	OE	输入 / 输出	模式	电源
H	X	X	高阻态	取消选择 / 断电	待机
L	H	L	数据输出 (DQ ₀ -DQ ₇) ;	读取	活动
L	H	H	高阻态	输出处于禁用状态	活动
L	L	X	数据输入 (DQ ₀ -DQ ₇) ;	写入	活动

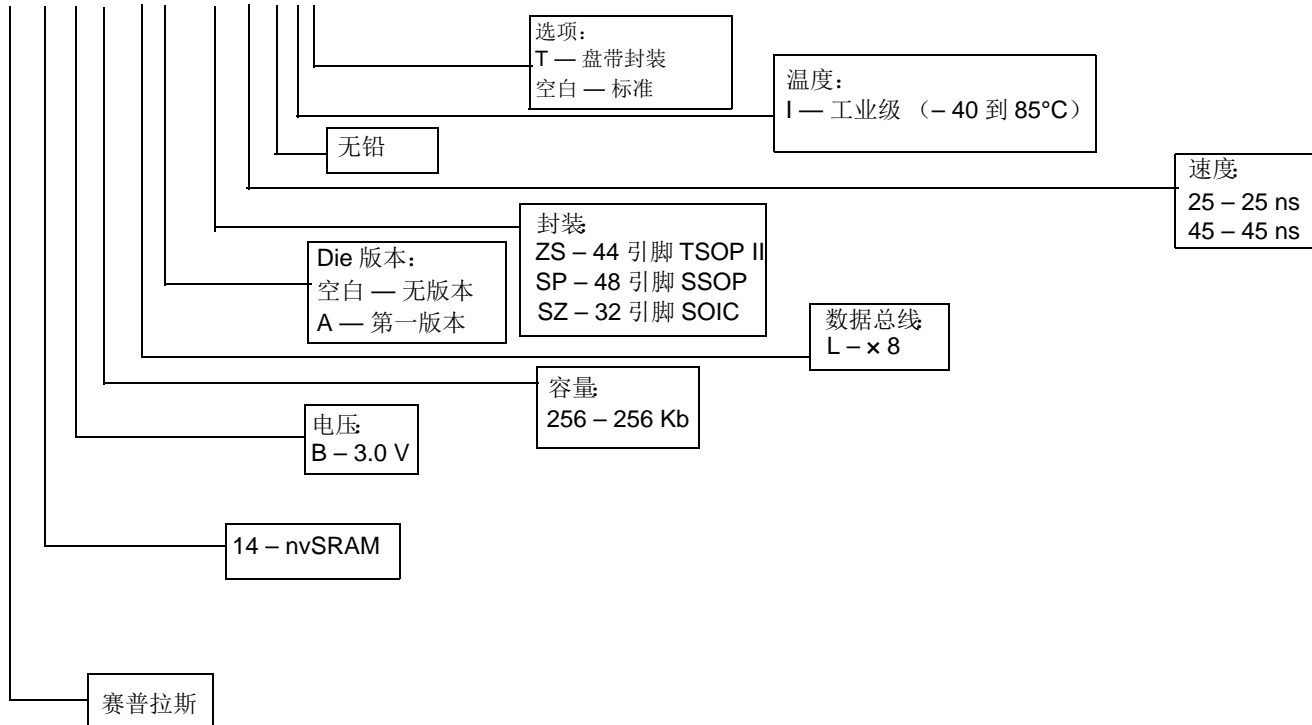
订购信息

速率 (ns)	订购代码	封装图	封装类型	工作范围
25	CY14B256LA-ZS25XIT	51-85087	44 引脚 TSOP II	工业级
	CY14B256LA-ZS25XI	51-85087	44 引脚 TSOP II	
	CY14B256LA-SP25XIT	51-85061	48 引脚 SSOP	
	CY14B256LA-SP25XI	51-85061	48 引脚 SSOP	
	CY14B256LA-SZ25XIT	51-85127	32 引脚 SOIC	
	CY14B256LA-SZ25XI	51-85127	32 引脚 SOIC	
45	CY14B256LA-SP45XIT	51-85061	48 引脚 SSOP	
	CY14B256LA-SP45XI	51-85061	48 引脚 SSOP	
	CY14B256LA-SZ45XIT	51-85127	32 引脚 SOIC	
	CY14B256LA-SZ45XI	51-85127	32 引脚 SOIC	

上述所有器件都是无铅的。

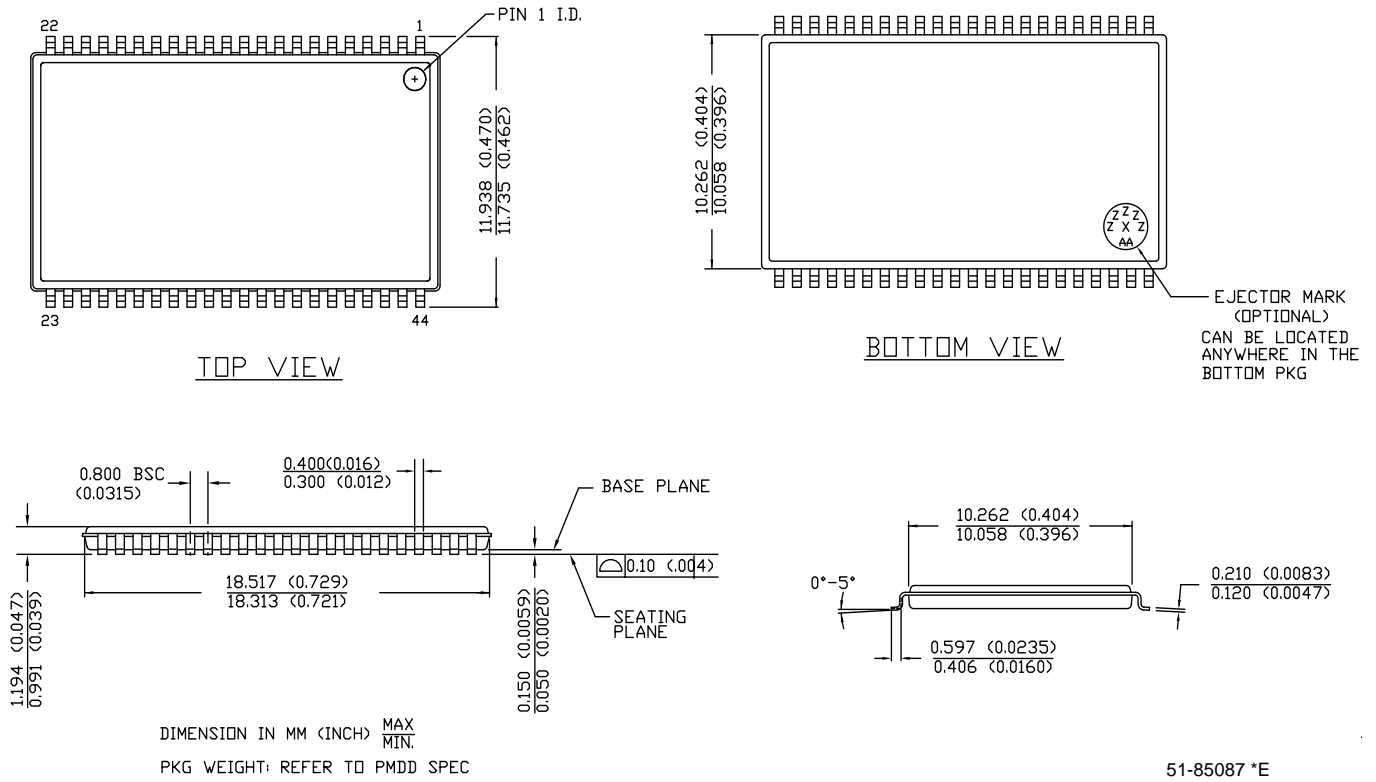
订购代码定义

CY 14 B 256 L A - ZS 25 X I T



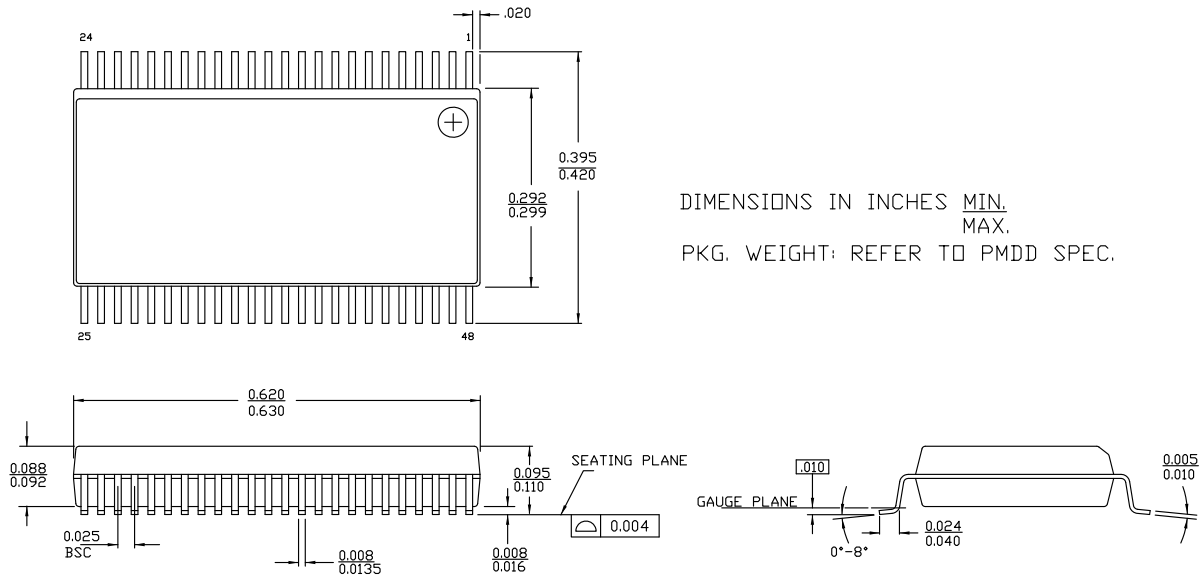
封装图

图 14. 44 引脚 TSOP II 封装外形, 51-85087



封装图 (续)

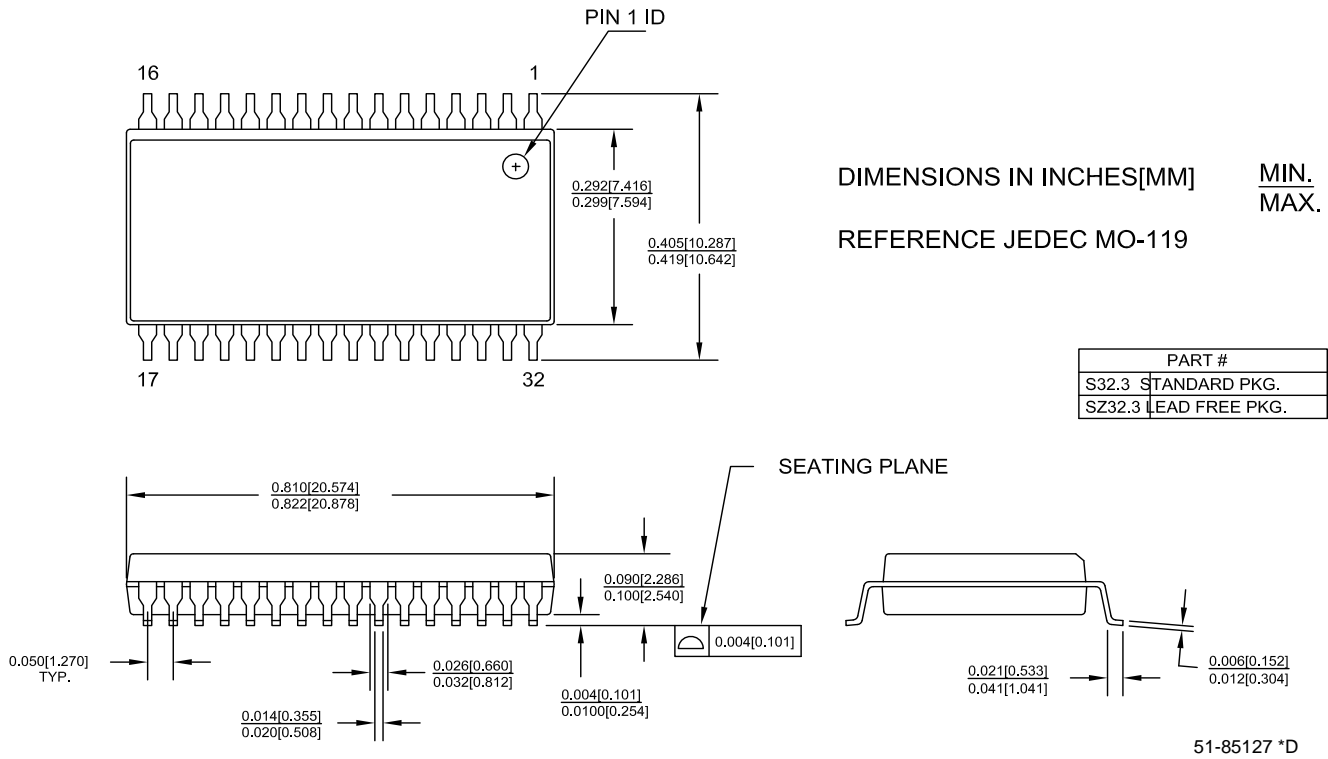
图 15. 48 引脚 SSOP (300 Mil) 封装外形, 51-85061



51-85061 *F

封装图 (续)

图 16. 32 引脚 SOIC (300 Mil) 封装外形, 51-85127



缩略语

缩略语	说明
CE	芯片使能
CMOS	互补金属氧化物半导体
EIA	电子工业联盟
HSB	硬件存储繁忙
I/O	输入 / 输出
nvSRAM	非易失性静态随机存取存储器
\overline{OE}	输出使能
RoHS	有害物质限制
RWI	禁止读和写
SRAM	静态随机存取存储器
SSOP	紧缩小外形封装
SOIC	小外形集成电路
TSOP	薄小外型封装
WE	写入使能

文档规范

测量单位

符号	测量单位
°C	摄氏度
k Ω	千欧姆
MHz	兆赫兹
μ A	微安
μ F	微法
μ s	微秒
mA	毫安
ms	毫秒
ns	纳秒
Ω	欧姆
%	百分比
pF	皮法
V	伏特
W	瓦特

文档修订记录页

文档标题: CY14B256LA, 256 Kbit (32 K x 8) nvSRAM				
文档编号: 001-95817				
版本	ECN	变更者	提交日期	变更说明
**	4691556	LYAO	04/01/2015	本档版本号为 Rev**, 译自英文版 001-54707 Rev*K。